

**PENGARUH PENGGUNAAN BERBAGAI LEVEL ONGGOK SEBAGAI  
PEREKAT TERHADAP KARAKTERISTIK FISIK WAFER RANSUM  
KOMPLIT BERBASIS JERAMI JAGUNG**

**Aria Mastur Rahmadan dibawah bimbingan**

**Akmal<sup>1)</sup> dan Rasmi Murni<sup>2)</sup>**

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui level terbaik penggunaan ongkok dalam pembuatan wafer ransum komplit berbasis jerami jagung (WRKJJ) dinilai dari kualitas fisik wafer. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan yaitu: WRKJJ-3 (Ransum komplit menggunakan 3% ongkok), WRKJJ-6 (Ransum komplit menggunakan 6% ongkok), WRKJJ-9 (Ransum komplit menggunakan 9% ongkok), dan WRKJJ-12 (Ransum komplit menggunakan 12% ongkok) masing-masing perlakuan diulang sebanyak 5 kali. Peubah yang diamati yaitu kadar air, berat jenis, kerapatan bahan, wafer durability indeks, dan daya serap air. Data dianalisis menggunakan Analisis Ragam (ANOVA) dan diuji Polinomial Orthogonal (PO) untuk mengetahui level optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan berbagai level ongkok sebagai perekat tidak berpengaruh nyata ( $P > 0,05$ ) terhadap kadar air (38,14%-40,36%), berat jenis (0,75 g/ml-0,77 g/ml), kerapatan wafer ( $0,22 \text{ g/cm}^3$ - $0,24 \text{ g/cm}^3$ ), dan daya serap air (182%-195%) namun berpengaruh nyata ( $P < 0,005$ ) terhadap wafer durability indeks (38,61%-92,99%) dengan persamaan  $y = -0.5869x^2 + 14.694x + 0.489$ . Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan ongkok sebanyak 12% merupakan level terbaik dalam pembuatan wafer ransum komplit berbasis jerami jagung dinilai dari kualitas fisiknya.

*Kata kunci: Jerami Jagung, Level Ongkok, Wafer Ransum Komplit, Sifat Fisik*

---

Keterangan: <sup>1)</sup> Pembimbing Utama

<sup>2)</sup> Pembimbing Pendamping